LD31铝合金电刷镀 SnPb钎料合金软钎焊

赵振清¹, 王春青¹, 杜 淼², 黄 毅¹ (1.哈尔滨工业大学, 哈尔滨 150001; 2.哈尔滨焊接研究所, 哈尔滨 150080)

摘 要:采用在 LD 31表面电刷镍阻挡层、铜改性层,将 LD 31铝合金的连接转化为铜的 连接,在镀铜层的表面电刷镀 SnPb钎料直接进行钎焊,通过开发低应力镀镍液和调整 电刷镀工艺参数解决镍过渡层的裂纹问题,研究分析了镀层的显微结构及表面状态,焊 缝的结构及元素分布,考察了焊接加热过程对镀层的影响。研究表明,通过在镀铜层表 面直接刷镀 SnPb钎料合金可以实现软钎焊连接,接头的抗剪强度可达 20MPa镀镍层、 镀铜层钎焊后无裂纹、剥离等缺陷产生。

关键词: LD31铝合金; 电刷镀; 镀层; 钎焊

中图分类号: TG 454 文献标识码: A 文章编号: 0253-360X(2005)07-67-05

赵振清

0序 言

采用 A1-Si钎料对铝及其合金真空钎焊, 因其 连接强度高, 焊缝成形美观, 是目前铝及其合金连接 最广泛采用的方法。但是相对于铝材的熔点, A1-Si钎料的温度相对较高, 因此在炉中钎焊时会发生 因炉温的不均匀分布而产生局部熔化, 而且, 高的钎 焊温度也会导致材料本身性能的下降^[1~3]。

采用温度较低的钎料如 Zn -A I钎料,虽然连接 强度也较高,但是由于钎焊接头的耐蚀性差,因此目 前应用较少^[4]。采用熔点更低的锡基软钎料,如 Sn - Pb钎料,由于钎料与母材成分差别大、相互作用 弱,焊缝钎料与母材的界面处生成一种不稳定结构, 而铝与钎料中的锡和铅电极电位相差很大,在电化 学腐蚀下界面很快破坏,因而无法实现可靠的连 接^[3]。

电镀、电刷镀等电化学沉积方法在电子工业中 应用非常广泛,大部分研究都集中在印刷电路板、元 器件引线表面沉积锡或锡基合金,以提高其软钎焊 性能^[67]。对于铝及其合金进行表面电沉积处理也 是通过电镀锡基合金用于提高其导电性,焊接性 等^[8]。

文中所要讨论的内容, 是一种 ID31 铝合金低 温软钎焊方法, 在 ID31 铝合金表面先电刷镀镍阻 挡层, 铜改性层, 将铝合金的钎焊转化为铜的钎焊连 接, 在铜镀层的表面再电刷镀 Sn – Pb低熔点钎料 合金后直接进行钎焊,这种方法的优点是,可以有效 解决采用锡基钎料钎焊钎缝的耐蚀性问题,通过控 制电刷镀钎料合金的厚度对钎料量进行精确控制, 从而实现对钎缝成形的控制。此研究可用于电子工 业中铝合金的低温精密连接。

1 试验方法及过程

1.1 电刷镀材料及方法

电刷镀过程中基体材料为 LD31 铝合金, 其规 格为 80mm×50mm×1.5mm, 电刷镀设备为 MBFK -50刷镀电源。

由于铝与氧有很强的亲和能力,表面上总有氧 化膜的存在,因此,在对 LD31铝合金进行电刷镀之 前,必须经过严格的预处理,此过程也是影响电刷镀 质量的关键。试验中,在电刷镀之前,依次经过有机 溶剂除油、化学除油、碱蚀、出光、浸锌、退锌、清洗等 预处理过程。

研究中采用的镀镍液的成分见表 1 其配制过 程是在 60 ~ 80 ^C的温度下以保证硼酸的溶解,电刷 镀镍层的刷镀电压为 3 V,电刷镀镍层的过程中镀 镍液温度保持在 60 ~ 80 ^C,以保证镀液中对氨基苯 磺酸的活性,防止镀镍层中裂纹出现,镀液的 pH 值 为 4 5. 铜镀液的成分见表 2 电刷镀铜的刷镀电压 2~3 V,镀液温度为 25 ^C,铜镀液的 pH 值为 7.5~ 8. 电刷镀 SnPb钎料合金镀层所采用的镀液成分见 表 3.

Table 1 Composition of electric brushing N i solution

| 成分 | 含量 g儿 |
|--------|----------|
| 氨基磺酸镍 | 500 ~600 |
| 硼酸 | 30 |
| 溴化钾 | 7 |
| 糖精 | 0. 5 |
| 对氨基苯磺酸 | 1 |

表 2 镀铜液化学组成

Table 2 Composition of electric brushing Cu solution

| 成分 | 含量 g儿 |
|--|-------|
| 硫酸铜(CuSO ₄ · 5H ₂ O) | 250 |
| 乙二胺 | 170 |
| 硝酸铵 | 50 |
| 硫酸钠 | 30 |

表 3 SnPb镀液化学组成

Table 3 Composition of electric brushing SnPb solution

| 成分及工艺条件 | 含量 g儿 |
|--|-------------|
| 二价锡[以 Sn(BF ₄) ₂ 形式加入] | 11. 5 ~15 5 |
| 铅[以 Pb(BF ₄) ₂ 形式加入] | 7~11 |
| 游离氟硼酸(HBF ₄) | 460 |
| 硼酸(H ₃ BO ₃) | 30 |
| 温度 <i>т /</i> ℃ | 15~30 |
| 电流密度 A /dm ² | 1~2 |

1.2 钎焊方法及工艺

将表面刷镀镍层、铜层、钎料合金层的试件切割 成 30mm×6mm×1.5mm的钎焊试件,将 BGA(球 栅阵列)水溶性钎剂均匀涂抹于钎焊件的待焊位 置,放入热风再流焊中进行钎焊,钎焊工艺见表 4

| 表 4 | 软钎焊工艺条件 |
|-----|---------|
|-----|---------|

| Table4 Paı | nam e ters o f | soblering | procedure |
|------------|----------------|-----------|-----------|
|------------|----------------|-----------|-----------|

| | 01 | |
|----------------------------------|----------|--|
| 工艺条件 | 参数 | |
| 预热时间 _{f1} /s | 100 ~120 | |
| 预热温度 $T_1 \ \mathcal{V}$ | 140 ~160 | |
| 液相线以上保温时间 5_/s | 60 ~90 | |
| 液相线以上最高温度 $T_2 \ ^{\mathcal{C}}$ | 250 ~260 | |
| 冷却温度 T ₃ ℃ | 100 ~120 | |
| 降温速率 v /(℃・m in ⁻¹) | 3~10 | |

2 试验结果分析

2 1 镀层厚度、缺陷、表面形貌

采用镍层作为打底层来保证铜镀层与铝基体间的结合强度,同时作为阻挡层阻止由于上层的铜层 或其它镀层的不均匀而引起的钎料层与母材 (LD31)的接触,而镀镍层厚度过厚由于应力大而在 镀层中产生裂纹等缺陷,因此,镍镀层的厚度应为3 ~5 μ m为宜。考虑到铜在液态钎料中钎焊过程中 的溶解,且在钎焊后应保留有一定的厚度,电刷镀铜 层的厚度为10~15 μ m,钎料(SnPb)层保证在钎焊 过程中提供的钎料量可以完成填缝过程,并且厚度 过大会造成钎焊后钎料的堆积,故钎料镀层的厚度 为15~25 μ m 为最佳。

21.1 镀镍层裂纹产生原理与控制

镀镍层介于镀铜层与铝基体之间,既起到过渡 铝与镀铜层或钎料层之间电极电位的作用,同时又 作为阻挡层,阻挡镀铜层或钎料层与铝基体之间接 触,以免造成镀层的破碎,降低整体的结合强度。当 镀镍层的质量差时,在钎焊的热冲击下,镀镍层、镀 铜层整体破碎,从铝基体剥离,见图 1,无法形成可 靠的钎焊连接。因此,在电刷镀过程中有效的控制 镀镍层裂纹的产生,是控制钎焊质量的关键。



图 1 镀镍层有缺陷时焊后界面照片

Fig 1 Soldering interface when defect was in Nicoating

采用快速镀镍液,将在镀镍层残留很高的应力, 在电刷镀镍层的最初过程中发现,镀镍层中有垂直 于基体表面且贯穿整个镀层的裂纹出现,如图 2a 镀层的内应力是由于电沉积过程中不平衡的结晶过 程引起的¹⁹。电沉积产生的微晶体,在邻近基体金 属的表面呈外延形成核,其晶格形式与基体金属的 晶格形式相同,随着厚度的增加,逐步过渡到镀层金 属固有的晶格类型。在这个薄层内产生晶格的扭曲 和变形,产生内应力。同时,电沉积产生的晶体之间 及晶体与基体金属之间的压缩作用,镀层金属中存 在的大量位错也是内应力产生的主要因素。在电沉 积过程中, 阴极上析出的氢存在于镀层之中, 镀液中 的杂质, 以及在阴极附近由于 pH 值升高而产生的 氢氧化物等被夹杂在镀层内, 使镀层的体积和力学 性能发生变化, 产生内应力。

为获得合格的镀镍底层,试验中自主开发了电 刷镀低应力底层镀镍液,镀液成分见表 1。其中氨 基苯磺酸为根据试验情况加入的,其结果是增加了 镀层中的压应力,减少了镀后晶间开裂的可能。而 且,只有在 60~80 [℃]的温度区间内,氨基苯磺酸的 活性才能最大,才能有效去除镀镍层的残余拉应力。 图 2b为调整镀液后镀镍层的剖面照片,从镀层的剖 面看,镀镍层无裂纹,且厚度均匀,约为 4 μm。



图 2 LD31 铝合金表面刷镀镍层的剖面照片

Fig 2 Cross section micrograph after LD31 a luminum was electric brush plated Nicoating

21.2 Cu镀层厚度控制

图 3为 LD31 铝合金表面依次电刷镀镍过渡 层,铜改性层后的剖面照片,从图中可以看出,镀镍 层厚度均匀,无裂纹缺陷。镀铜层的厚度为 10 ^µm, 满足试验设计要求,镀层厚度均匀,致密,无明显缺 陷,与镀镍层结合良好。

21.3 电刷镀 SnPb 后表面状态及元素分布

图 4显示的是 LD31铝合金表面依次电刷镀镍 层、铜层、SnPb合金镀层后 SnPb合金镀层表面的形 貌照片。图 4a为刷镀电压为 4V时 SnPb镀层的表 面照片,图 4b为刷镀电压为 3V时 SnPb镀层的表 面照片。钎焊结果表明,当表面状态为图 4a所示 时,无法实现钎焊连接,而当表面状态为图 4b所示 时,可以实现钎焊连接,这可能是由于在高的电流密 度下 Sn局部出现氧化的结果。从图 5所示的元素 的面分布照片中可以看出电刷镀产生的 SnPb钎料 合金镀层微观凹凸不平,为一层绒毛状结构,厚度约 为 20 µm,从后续的软钎焊过程来看,由于钎料合金 的熔化,微观的表面不平整对钎焊性无影响。从电 刷镀后镀层结构中铝、镍、铜、锡、铅等元素的面分布 来看, SnPb钎料合金镀层中锡的含量远高于铅的含 量。



- 图 3 LD31铝合金表面刷镀镍层、铜层后的剖面照片
- Fig 3 Cross section micrograph after LD31 alum num was electric brush plated Ni and Cu coatings



图 4 电刷镀 SnPb镀层表面形貌

Fig. 4 Morphobgy in age of SnPb coating

2 2 钎焊结果及界面分析

从电刷镀镍层、铜层、SnPb针料合金层后炉中 钎焊的情况来看,在配合 BGA 水溶性钎剂钎焊时, 镀层有很好的钎焊性能,刷镀的钎料合金镀层在钎 焊时流动性、填缝性俱佳,形成的钎缝饱满,见图 6. 图 7为 SnPb钎料合金与镀铜层的界面处的扫描电 镜照片,在镀铜层与 SnPb合金镀层之间形成了一层 很薄的金属间化合物,对其进行 EDX(X 射线能 量分析)结果见图 8.其中铜 54.26%,锡45.74% (摩尔分数),经分析此化合物为 Cu₆Sn₅,钎缝中钎 料中的白色相为富铅相,说明 SnPb钎料合金层在钎 焊过程中与镀铜层之间有冶金反应发生。钎焊后镀 层与镀层之间、镀层与基体之间结合紧密,无镀层之 间的脱落和剥离现象,说明镀层之间的结合能够承 受钎焊加热过程的影响。



图 5 LD31铝合金刷镀镍、铜、SnPb钎料镀层后各元素的面分布 Fig. 5 Elements face distribution of as deposited Ni Cu and SnPb solder coatings



图 6 刷镀 SnPb钎料合金钎焊后焊缝 Fig 6 Solder pintafter soldering with electric brush plating SnPb solder alloy



图 7 钎焊后 SnPb钎料与镀铜层界面 Fig 7 Intenface of SnPb sokler and deposited Cu coating



图 8 SnPb针料与镀铜层界面化合物 EDX分析

Fig. 8 EDX analysis of intermetallic compound at SnPb solder and Cu coating interface

23 力学性能测试分析

为了进一步检验电刷镀后的钎焊质量,将电刷 镀后钎焊的试件进行了拉伸试验,拉伸试验在室温 下进行,拉伸速率为 1 mm *m* in 拉伸曲线见图 9. 拉 伸试验结果表明,拉伸钎焊接头断于钎缝中钎料部 分,接头的抗剪强度达到 20 MPa 对拉伸断口观察 分析表明没有镀铜层、镀镍层从 LD31铝合金基体剥 离的现象,镍层中也没有裂纹产生,进一步说明镀 (3)通过将焊缝区域分成若干区域并逐步杀死 和激活的方法实现了不规则路径的焊缝填丝问题。

参考文献:

- [1] 程良骏. 水轮机[M]. 北京: 机械工业出版社, 1982 18-29
- [2] Sotnikov A A. A russian tubine experience[J]. Water Power of Dam Construction 1998 50(5): 45-48.
- [3] Baetz J.P. The repair welding of ARSW N runner [J]. Journal of Hydraulic Research 1986 24(3): 45-50
- [4] 孙鸿秉. 岩滩水轮机转轮叶片裂纹原因探析[J]. 红水河, 1995 15(3): 32-37.
- [5] WuYangao LiWushen, ZouHongjun, et al State of the art of

[上接第 70页]

镍层与 LD31铝合金之间, 镀层与镀层之间接合强 度能够满足钎焊连接的要求。



图 9 拉伸载荷 --位移曲线 Fig 9 Curve of tensile bad with tensile displacement

3 结 论

采用 LD31铝合金表面电刷镀镍过渡层、铜改 性层, SnPb钎料合金层后直接进行软钎焊连接, 能 够实现 LD31铝合金的可靠连接, 连接的抗剪强度 达到 20MPa 使用低应力镀镍液和调整电刷镀工 艺, 有效地解决了镍过渡层的裂纹问题; 在铜表面电 刷镀 20 μm厚的 SnPb 钎料合金, 钎焊性能好, 钎缝 成形好; 镀镍层和 LD31铝合金基体之间、镀层与镀 层之间结合良好, 钎焊后拉伸试验钎缝断于钎料合 numerical sinulation in welding [J]. Transactions of the China Welding Institution 2002 23(3): 89-92 吴言高,李午申,邹宏军,等. 焊接数值模拟技术发展现状 [J]. 焊接学报, 2002 23(3): 89-92

- [6] 蔡志鹏. 电子束焊接数值模拟中分段移动双椭球热源模型的
 建立[J]. 机械工程学报, 2004 40(1): 23 27.
- [7] 鹿安理. 焊接温度场、应力场和应变场相似准则的推导及验证[J]. 中国机械工程, 2001, 12(10); 1165 1169.

作者简介: 姬书得, 男, 1977年生, 博士研究生。主要从事水轮 机转轮失效方面的研究, 发表论文 8篇。

Email superjsd@hit edu. cn

金, 镀层无脱落、剥离, 可以承受钎焊过程的热冲击, 镀层结合强度满足钎焊的要求。

参考文献:

- Sugiyama Y. Brazing of alum inum alloys [J]. We kling International 1989 3(10): 700-710
- Hattori T, Sakai S Sakamoto A, et al Brazeability of aluminum in vacuum – nitrogen partial pressure atmosphere brazing [J]. Welding Journal 1994 73(10): 233-240.
- [3] Kawas H. Takemoto T. Asano M. et al. Study of a method for evaluating the brazeability of a huminum shee[J]. Welding Journal 1989. 68(10): 396 s 403 s
- [4] 张启运, 庄鸿寿. 钎焊手册 [M]. 北京: 机械工业出版社,
 1999.55-56.
- [5] 邹 禧. 钎焊[M]. 北京: 机械工业出版社, 1989 104-05.
- [6] 庄瑞舫. 锡和锡基合金镀层的可焊性研究[J]. 电镀与精饰, 1997, (7): 4-11
- [7] 马今朝.无铅可焊性镀层及其在电子工业中的应用[J].电子 工艺技术,2000 (5): 98-100
- [8] 钟建武. 铝及铝合金电镀高可焊性锡基合金工艺[J]. 材料保
 护, 2002. (11): 41-43.
- [9] 林春华,葛祥荣. 电刷镀技术便览[M].北京:机械工业出版 社,1991.185-186

作者简介:赵振清,男,1973年出生,博士研究生。主要从事电子组装与封装、精密钎焊连接等研究工作,发表论文 7篇。

Email zhaozq@hit edu cn

welded by using scanning heating technology to prepare the powdermetal lugical transition layer

Keywords electron beam (EB); scanning controlsystem; scanning trads; energy control

D iffusion bond ing of TC4 N i QA II 0-31.5 GUO W e¹, ZHAO X i hua¹, SONG M in xia¹, FENG Ji ca², YANG Biao¹ (1 School of M a teria, I ji lin University Changchun 130025 China 2 State K ey Laboratory of Advanced W ekling Production Technology Harbin Institute of Technology Harbin 150001 China). p63 – 66

Abstract TC4 and QA II θ 3 1 5 were diffusion bonded with N i interlayer The diffusion bonded joints were evaluated by scanning electron microscopy (JEOL JSM 6700F) and its attaching energy dispersive spectroscopy(EDS). In term etallic compounds at the interface were detected vie X-ray diffraction (XRD) and microhardness tests and tensile test ings were done to evaluate the properties of bond joints. The results indicated that TC4 and QA II θ 3-1 5 with N i interlayer were bonded fim ly under the condition of 870 $^{\circ}$ tem peratures 10M Pa bond stress and 60 m in holding time and the bond strength was up to 325M Pa furtherm ore various reaction bands appeared in the diffusion zone and N iTi phase (N iTi + N i₃ Ti) phase and N i(Cu) so lid so lution were produced at the interface zone

Keywords diffusion bonding titanium alloy, copperalloy, Ni interlayer microstructure

Soldering of LD31 a hum inum alby with electro brush p lated Sn Pb albys ZHAO Zhen qing¹, WANG Chun qing¹, DU M iao², HUANG Y i¹ (1 Harbin Institute of Technology Harbin 150001, China, 2, Har bin Welding Institute Harbin 150080, China). p67 – 70, 74

Abstract The bonding of LD31 alum inum alloy with electron bush plated Sn Pb solder after the deposition of N i and Cu transient layers was investigated in this paper. The influence of electric deposition parameters of SnPb alloy on the coating quality and subsequent solderability was studied. The constitution of coatings, the morphology of Sn Pb coating the bondingmechanism in the soldering and the elements distribution in the soldered joint were studied by scanning electron microscope energy dispersive X-ray analysis and metallographic analysis. The results of soldering experiment showed that after the deposition of N i and Cu coatings, the bonding of LD31 alum inum alloy could be transformed to the bonding of copper- and the bonding of coatings could bear the heating condition in the soldered. The shear strength of the soldered joint could reach as high as 20 M Pa

Keywords LD31 alum inum alloy electron brush plating coat ing soldering

Particularity analysis of Francis turb in e runner's sinulation during

welding JI Shur de FANG Hong yuan LIU Xue song MENG Qing guo(Harbin Institute of Technology Harbin 150001, China). p71 - 74

Abstract A in ing at the particularity of Francis turbine runner's sinulation in the process of welding the method was adopted which solved the loading of welding thermal source by means of node to node connection and the method was brought forward which solved the problem of weld's wire feed by dividing the weld into many parts. These two methods were proved reasonably by the runner's temperature field. More over the problem of heat conduction between independent entities and the problem of heat elimination between blade and air were successfully solved by using contact bodies. It had in portant guiding significance to the numerical sinulation of complicated weldments.

Keywords runner welding numerical sinulation, ken perature field

O ptin ization of water dissolution modification process using silver brazing fluxes CHEN Hai yan, LIWeim in LIFeng SHU Chang (Faculty of Material and Energy Guangdong University of Technology Guangzhou 510643, China). p75 – 76 80

Abstract The optimization of the water dissolution process using silver brazing fluxes was conducted by orthogonal test. The test result showed that effect of bake time on flux property is the best notable next proportioning of compositions affected flux property then bake temperature affected flux property. The optimum process parameters are component of 42% KF+23% KBF₄+35% B₂O₃ bake time of 45 m in and bake temperature of 350 °C. By using the silver brazing fluxes the best results of the jointing can be carried out

Key words silver brazing flux orthogonal test absorptivity melting point spreading property

Modeling of welding pool surface reflectance of aluminum alby pulse GTAW LI Laiping CHEN Sharrben, LIN Tao (School of Materials Science and Engineering Shanghai Jiao tong University Shang hai 200030 China). p77 – 80

Abstract The key to the surface height calculation of pulse GTAW welding pool based on shape from shading (SFS) is to build up a surface model of welding pool Based on the in aging characteristics of a lum inum alloy pulseGTAW welding pool the surface reflectancemodel is built after analyzing are intensity filter system, welding pool shape and reflectance characteristics W ith smooth constraint condition of the welf ing pool surface and variable factor successive over relaxation (SOR) method the height of welding pool surface is calculated and the error is analyzed

Key words a luminum alloy pulse GTAW; surface reflectance model of welding pool shape from